



採購規範書

單號：A512002905

品名：半導體應用實作開發工作坊

目 錄

1. 目的/用途說明
2. 規格/功能需求
3. 重要規格、功能檢測/驗收標準
4. 交貨期
5. 廠商交付文件



1.目的/用途說明：

為執行115年「半導體創新技術與產業應用驅動智匯菁英計畫」，串聯產學研界技術資源與能量，透過半導體應用實作開發工作坊，協助在校生運用國產晶片/平台/系統/元件/軟硬體進行解題實作，經由產學研指導師從旁輔導實作解題、產出專題，累積實戰經驗與實戰能力，加速人才畢業即投入半導體產業服務，進而強化我國半導體產業即戰力。

2.規格/功能需求：

- (1)授課時間、場次：於民國（下同）115年8月底前完成舉辦2場次
- (2)授課時數：單日課程至少6小時
- (3)授課地點：臺北1場次、高雄1場次，且需鄰近大眾交通工具設施或視情形安排交通接駁
- (4)執行人員：
 - A.講師：至少3位以上半導體及AI應用領域產學研專家
 - B.助教數名：協助課前事務籌備/教材製作、正式課程輔助、課後資料整理等
 - C.視情況工作人員數名
- (5)學生人數：不同科系之在學大學生與碩士生（含外籍生、僑生）約40-60人
- (6)課程內容：【運用國產晶片/平台/系統/元件/軟硬體，聚焦半導體技術與產業應用情境進行解題實作】，需涵蓋以下項目：
 - A.介紹國產晶片/系統開發平台技術能量
 - B.介紹產業應用情境（如物聯網、人工智慧）及實績
 - C.以解題實作方式，讓學生熟悉運用國產晶片/系統開發平台進行創新應用開發
- (7)課程相關事宜：
 - A.課程執行內容事先須與本院充分溝通並達成共識
 - B.開課前，須製作、提供學生「開訓手冊」乙式，內容須包括課程介紹及議程、講師簡介、上課攜帶物品清單、教室位置、交通資訊、單一聯絡窗口資訊等重要提醒事項



C.須依參與人數安排妥適內容（如葷素、避免引發過敏食材等）及數量之餐點，如飲水、茶點、便當等

D.依活動性質及參與人數，辦理符合法規之公共意外責任保險

E.教室需有適當布置呈現計畫、活動名稱，以利照相記錄

3. 重要規格、功能檢測/驗收標準：

完成下列各期資料處理，並符合規格要求。

第一期（115/7/15）：完成下表工作項次一(執行企劃)，經本院確認驗收資料無誤後本院將支付本案採購總金額之30%。

第二期（115/9/14）：完成下表工作項次二(工作坊舉辦)、三（執行成果報告），經本院確認驗收資料無誤後本院將支付本案採購總金額之70%。

項次	重要規格/功能內容	驗收標準
一、半導體應用實作開發工作坊執行企劃	依照本規劃書 2.規格/功能需求規劃細部執行內容，完成製作「半導體應用實作開發工作坊執行企劃」1份	經本院審查通過
二、舉辦半導體應用實作開發工作坊	完成舉辦半導體應用實作開發工作坊 2 場次	完成舉辦半導體應用實作開發工作坊 2 場次
三、半導體應用實作開發工作坊執行成果報告	完成「半導體應用實作開發工作坊」執行成果報告 1 份，內容須包括： 1. 課程介紹及議程、教材、講師學經歷簡介（須說明符合半導體及 AI 應用領域產學研專家） 2. 講師/助教/工作人員/學生簽到 3. 課程照片 4. 課程滿意度調查及結果分析	經本院審查通過

4.交貨期：115 年 9 月 14 日前

5.廠商交付文件：有 無

(1)文件種類/格式：請視文件內容屬性以 Microsoft Office 可編輯格式製作及提交檔案（如 .docx、.xlsx、.pptx）

(2)交付時間：依本規劃書 3. 重要規格、功能檢測/驗收標準

(3)紙本/電子檔份數：各1份

(4)語言：原則繁體中文，科技專有名詞或特殊情況可使用外文